高分辨率二维和三维X射线系统

产品名称	高分辨率二维和三维X射线系统
公司名称	安赛斯（北京）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国 型号:FF70 CL 产地:德国
公司地址	北京市海淀区建材城中路3号楼6层中段606室
联系电话	01082980790 13521278201

产品详情

高分辨率二维和三维X射线系统 FF70 CL

安赛斯（中国）有限公司

适用于全自动分析最小缺陷的高分辨率二维和三维X射线系

由于晶片、基板、带材上或最终产品的组件中存在缺陷，因而在半导体制造中，需借助自动化、高质量、可靠、快速的无损检测和分析来实现最佳生产。新型FF70 CL X射线检测系统专门设计用于对这些样品中最小
和最苛刻的缺
陷进行最佳自动化分析。结
果：测试和检测非常精确且可重复，性能出色。（请登录www.analysis-tech.com获取更多信息）

l 改善质量监控，以更高的分辨率检查更多的位置，从而确定可能遗漏的故障

l 通过更佳的测试覆盖率显著降低成本，从而提高产量

l 可随时对工艺和缺陷参数的一致性进行可靠和可重复检查

l 该创新自动化分析解决方案易于使用，优化了操作成本

系统能力

FF70 CL具有较大的检测面积，即，510 x 610mm，以及极精细的检测深度，即，小于150nm，非常适合对三维集成电路、芯片和晶片中的焊接凸点和填充过孔进行自动、无损分析。

系统操作台的创新真空机制在分析过程中能够安全、精确地保持样品，并抵消样品翘曲的影响。

FF70 CL提供二维（自上而下）高性能平板探测器和三维（CL-计算机分层摄影）自动分析，使用高分辨率图像增强器在特殊操作组件内进行倾斜旋转。

最新一代的纳米焦点X射线管可生成能显示和测量最小空隙和功能的二维和三维图像，使FF70 CL能够分析最苛刻的先进半导体难题。

图形用户界面（GUI）便于使用且直观，允许用户轻松创建自动化、多点和多功能分析检测程序。

自动、连续监测系统各个方面的背景校准测试，可以确保随时间变化的测量重复性。

系统属性一览：

l 可执行自动化高通量分析，重复性良好且结果可靠

l 可简单创建自动化、多点和多功能分析检测程序，允许样品和测量任务之间的快速变化

l 可执行持续背景监测和优化，确保测量重复性和准确性

技术数据

Attribute	Respective Value
Sample Diameters	795 [mm] (30.1")
Sample Height	150 [mm] (5.7")
Maximum Sample Weight	2 [kg]
System Dimensions	1940 x 2605 x 2000 [mm]
CT Modes	Ultra-high resolution Computed Laminography (CL)
Manipulation	Ultra-precise manipulator, active anti-vibration system, reliability

详细产品技术参数，请向安赛斯工作人员索取。